

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年9月29日(29.09.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/202771 A1

(51) 国際特許分類:
B32B 15/08 (2006.01) H05B 33/02 (2006.01)
B32B 15/09 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/013028

(22) 国際出願日: 2022年3月22日(22.03.2022)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2021-048712 2021年3月23日(23.03.2021) JP

(71) 出願人: J F E スチール株式会社(JFE STEEL CORPORATION) [JP/JP]; 〒1000011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 藤本 聡一 (FUJIMOTO Soichi); 〒1000011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 J F E スチール株式会社知的財産部内 Tokyo (JP). 大島 安秀(OSHIMA Yasuhide); 〒1000011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号 J F E スチール株式会社知的財産部内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 熊坂 晃, 外(KUMASAKA Akira et al.); 〒1000004 東京都千代田区大手町二丁目7番1号 J F E テクノリサーチ株式会社知的財産事業部内 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL,

CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告(条約第21条(3))

(54) Title: FILM-LAMINATED METAL SHEET, METHOD FOR MANUFACTURING SAME, SUBSTRATE FOR FLEXIBLE ELECTRONICS, AND ORGANIC EL SUBSTRATE

(54) 発明の名称: フィルムラミネート金属板およびその製造方法、ならびにフレキシブルエレクトロニクス用基板および有機EL用基板

(57) Abstract: The present invention provides a film-laminated metal sheet, a method for manufacturing the same, a substrate for flexible electronics, and an organic EL substrate that not only have satisfactory smoothness, heat-resistance, flexibility, and gas barrier properties but also have exceptional producibility and impose little burden on the environment. Provided is a film-laminated metal sheet in which at least one surface is coated with a resin film, the film-laminated metal sheet being such that the arithmetic mean roughness Sa of the resin film surface is 0.030 μm or less, the maximum peak height Sp of the resin film surface is 0.30 μm or less, and the maximum valley depth Sv of the resin film surface is 1.0 μm or less.

(57) 要約: 平滑性、耐熱性、フレキシブル性、及びガスバリア性を満足するだけでなく、環境負荷が低く生産性にも優れるフィルムラミネート金属板およびその製造方法、ならびにフレキシブルエレクトロニクス用基板および有機EL用基板を提供することにある。少なくとも片面が樹脂フィルムで被覆されているフィルムラミネート金属板であって、前記樹脂フィルム表面の算術平均粗さSaが0.030 μm以下であり、前記樹脂フィルム表面の最大山高さSpが0.30 μm以下であり、前記樹脂フィルム表面の最大谷深さSvが1.0 μm以下である、フィルムラミネート金属板。

WO 2022/202771 A1